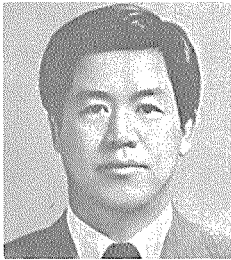


美·日 半導体 協商과 影響



張 東
韓國電子(株) 半導体事業部 理事

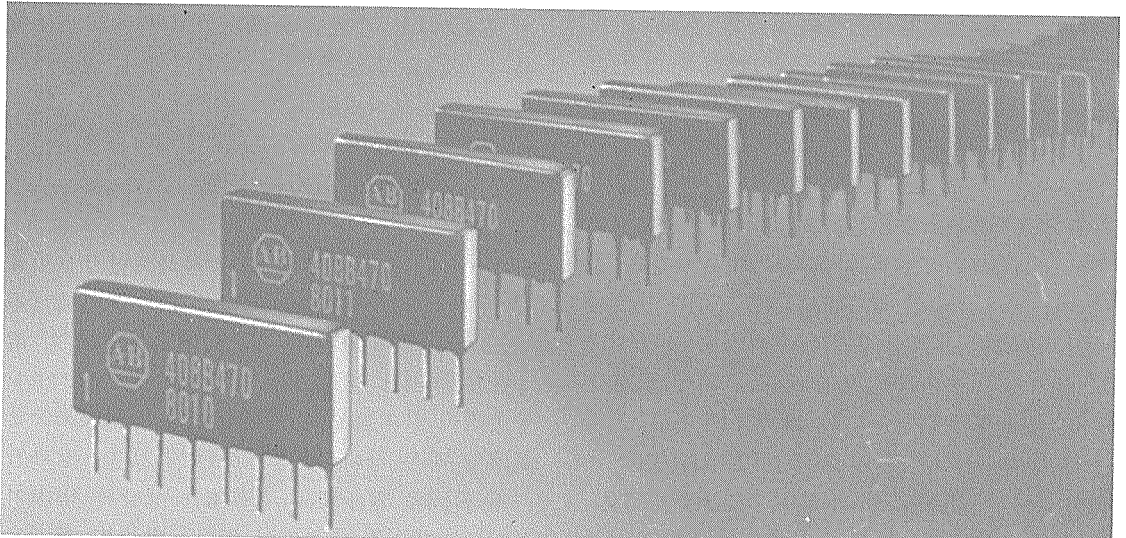
1981년 초부터 시작된 미·일간의 반도체 마찰은 크게 두가지로 요약된다. 무역균형측면에서 미국의 일본에 대한 개선 요구가 관철되지 않아 과감한 보복조치가 감행될 예정이며, 국방 하이테크 전략기술 측면에서 미국의 열세 만회를 위한 자구책인 것이다. 따라서 한국은 가격경쟁력의 제고로 대미수출 증가가 예상되나 일본의 전철을 밟지않도록 해야 한다.

1. 美·日 半導体 協商은 결국 破局으로 갈 것인가

美國의 전통적 産業이었던 鐵鋼産業이 脫産業化 및 製造業의 空洞化에 의해 日本産 製品에게 무차별 蹂躪당했을 때도 깨끗이 相對的 힘의 쇠퇴를 認定했던 美國이 「産業의 쌀」이라고 이야기하는 半導体産業에 關한 한 國際競争 優勢를 방법과 수단을 가리지않고 絶대 양보하지 않을 속셈인 것 같다. 「美國은 絶대 白旗를 들지 않는다」 하는 말이 실감나는 昨今이다.

美·日間의 半導体 摩擦은 81年初로 거슬러 올라간다. 日本製 64K DRAM의 美國 Market Share가 70% 以上임이 밝혀짐으로써 美國 業界에 충격으로 받아들여져 SIA(美國 半導体工業會)를 중심으로 日本의 半導体産業 政策을 비판하고 나서며 半導体 Chip 保護 育成法을 施行(85年 1月 施行)하는 등 크고 작은 紛爭이 있어 왔으나, 이와 같은 半導体 紛爭이 결국은 美國과 日本 兩國의 파국을 몰고 올 것이라는 데 인식을 같이하고 지난 86年 7月 日本은 향후 1991년까지 5年間 Cost와 輸出價格을 감시할 뿐만 아니라 外國産 半導体 輸入을 적극 장려한다는 내용으로 美·日 半導体 協定을 체결한 것이다.

이에 따라 半導体 對美 輸出分은 美國 政府가 정한 公正 輸出價格(FMV)으로 輸出하며 美國 以外的 第3國 輸出分은 Cost를 기준하여 監視價格 이상으로 거래하도록 하고 美國 半導体 製品의 日本市場 占有率을 향후 5年間 20%까지 확대시키는 것으로 되어있으나 協定 체결 1年이 가까와 오도록 美國은 日本이 아직도 Dumping 輸出을 자행하고 있으며 日本市場을 개방하지 않는 등 약속을 지키지 않고 있다고 보고 본격적인 報復措置를 단행하려고 하고 있는 것이다.



미·일간의 마찰을 교훈삼아 과대홍보 및 가격경쟁을 지양하고 내실을 기해야 한다.

이번 半導體 摩擦의 재연은 円高 - 低달러에도 불구하고 日本의 對美 貿易黑字가 개선되지 않고 있는데 대해 美 議會나 行政府의 불만이 고조되고 있던 次에 閣僚級 經濟問題 最高決定 機構인 白堊館 經濟政策 委員會(EPC)가 對日 半導體 報復措置를 결정, 레이건 大統領에게 촉구한 적이 있다.

이에 美 레이건 大統領도 3月 27日 드디어 日本産 半導體를 사용한 製品에 대해서 約3億 弗의 報復関稅를 賦課할 것이라고 정식 宣言하기에 이른 것이다.

報復 対象品目은 아직 未確定되고 있으나 Computer, Color & B/W-TV, Car Audio, VTR, Telephone, 他部品 등이 예상되고 있다.

다만 半導體 자체는 이를 輸入製品化하고 있는 美国企業들에게 피해를 줄 우려가 있다고 판단, 報復対象에서 제외될 것이라 한다.

美国의 마이크로 테크놀로지사가 証憑資料를 提示한 바와 같이 日本 沖電氣가 東南亞에서 256K DRAM 4,000個를 1個당 1.89弗로 Dumping했고 또 홍콩에서는 日本 日立, 沖電氣가 1個당 1.89~1.95弗로 수천個를 輸出하는 등 Dumping 事例는 셀 수 없을 정도로 많은 것도 사실이다.

公正市場價格(FMV)이 1~3月中 256K DRAM의 경우 1個가 2.6~2.9弗에 비교하면

30%~40%싼 Dumping 價格이 분명하다고 主張하고 있는 것이 美国의 입장이다. 조그마한 旅行用 가방에 몇천개씩 은밀히 숨겨서 運搬해 가는 方法. 아니면 半導體를 PCB에 적당히 Soldering하여 半導體를 사용한 製品으로 둔갑시킨 뒤 목적지에서 다시 半導體를 떼어 내어 販賣하는 등 監視價格을 피하는 소위 Gray Market 등도 결코 무시할 수 없는 상황이니 美国側으로서도 強硬方針을 쓰지 않을 수 없는 것 같다.

즉 작년 半導體 7月 協定 締結以後 半導體의 對美 輸出價格은 현실화되었음에도 불구하고 第3國을 통하여 Dumping 行爲가 자행될 때에 美国 半導體의 Market Share의 잠식 또는 逆輸入의 불이익을 절대로 감수하지 않겠다는 의사로 해석되는 것이다.

한편 美半導體의 日本内の Share 擴大는 현재 約 9%로 20%까지에는 아직도 거리가 멀며 근본적으로 日本이 美 半導體의 日本內 Share 擴大에 성의를 보이지 않고 있으며 또한 그렇게 할 생각도 가지고 있지 않다고 믿고 있는 것 같다.

물론 日本側도 美·日 半導體 摩擦을 극소화시키기 위하여 20% 減産指導方針을 3月 23日 분명히 했으나 對美貿易 不均衡 全体中 半導體가 차지하고 있는 비율은 0.8~1.2% 밖에 안

된다는主張이고 製品價格의 하락화 추세 円貨 強勢의 不況下에서 손발을 묶는 것이 현명한 方法이나 하는 日本業界의 반발도 예상이 되는만큼 어느 정도 實効를 거둘지는 조금 더 두고 볼 일이다.

貿易戰爭의 새 樣相이라고 표현되는 현재의 美·日 半導體 摩擦의 다른 숨겨진 사정은 없는 것일까? 美國防省(PENTAGON)은 今年 2月 「美國은 半導體에서의 우위성이 상대적으로 급격히 떨어져 國家安全保障上 시급한 強化 등을 세울 필요가 있다」는 報告書를 냈다.

이 報告書는 Memory를 中心 軍事目的用 半導體로써 그 重要性을 더해가는 GaAs 半導體, 半導體의 Packaging 등에서 日本이 Lead 하고 있다고 결론을 내고 美國은 日本에 비해 生産性이 낮고 品質도 떨어진다고 보고되고 있으며 이의 만회를 위해서는 業界共同 研究所를 설립, 半導體 효율을 높이고 Yield를 향상시킬 수 있는 基礎技術을 개발해야 한다고 지적하고 있다. SIA는 즉시 「最高 水準의 半導體를 海外(日本)에서 供給받는다」는 것은 國防上 대단히 위험한 일이다」라고 성명을 내고 있다.

以上에서 보는 것처럼 半導體 摩擦은 일반적인 貿易의 不均衡上의 문제가 아니고 美國은 半導體産業을 國防上의 觀點에서 몇안되는 High Tech 中에서도 절대 양보할 수 없는 戰略的 技術로 중요시하고 있다는 점이다. 86年 11月 日本 富士通(Fujitsu)가 Fairchild의 株式 80%를 引受 企業買収에 합의하였으나 Fairchild가 軍事目的의 Chip을 多量 生産하고 있다는 이유 때문에 國防上의 문제가 되어 美國政府의 認可 거부로 買収決裂을 같은 맥락에서 보아야 할 것이다.

이렇게 美國과 日本의 상호 이해가 상충되는 이번 日本電子製品의 報復關稅 賦課는 美國의 거듭되는 強行方針에 日本도 매우 당황하는 눈치이며 Super Computer 輸入, 半導體減産 등 최대한의 성의를 보이는 한편 正面으로 맞서 작년 7月 締結된 半導體 協定도 파기한다는 強硬論도 나오고 있어 視覺이 다르고 經濟的 死活을 걸고 있는 美·日이 쉽게 해결책을 찾으리라고는 생각되지 않으나 美·日 兩國이 破局을 월

치 않는 以上 극적인 協商妥結策이 나와 自由貿易의 基底를 흔들지 않는 범위내에서 매듭지어 질 것이라 보여진다.

2. 우리에게 미치는 影響

美·日間의 半導體 摩擦을 바라보면서 미묘한 우리의 입장에 새삼 여러가지가 생각되어진다. 3低의 德에 昨今 活氣에 넘쳐있는 우리의 電子産業 半導體 生産에 미치는 영향은 무엇인가?

美國이 日本製品에 대해서 높은 報復關稅를 賦課할 경우 상대적으로 價格競爭力이 강화되어진 韓國産 電子製品 半導體가 상당히 輸出이 늘어날 것으로 기대되어진다. 대부분 美國으로 輸出되고있는 半導體는 日本의 減産效果에 힘입어 物量的으로 늘어날 展望이고 價格的 側面에서도 256K DRAM의 경우 2弗線에서 輸出되어 질 것으로 보여진다. 그러나 對美 輸出이 급격히 늘어날 경우 對美貿易 黑字國인 韓國이 日本과 비슷한 規制를 당할 확률은 대단히 높은 것으로 지적되고 있다.

더우기 相當數의 日本産 半導體를 사용하고 있는 國産 電子製品의 경우 언제 規制를 당할지 알 수 없는 일이다.

따라서 과거와 같은 소나기식 대량 輸出은 지양하고 輸出先도 多邊化해야 될 것이며 通商外交도 적극 強化하는 한편 合理化를 적극 推進 品質을 높이고 Cost를 낮추는 데 적극 힘써야 할 것이다.

우리나라 半導體産業은 짧은 歷史에도 불구하고 256K DRAM을 開發 輸出을 하고 있고 1M DRAM도 開發이 끝난 상태이고, 電子技術 研究所를 중심으로 4M DRAM의 開發을 서두르고 있다. 다만 開發成果를 對內外的으로 過剩 弘報를 自制할 필요가 있다.

日本 NTT의 16M DRAM 開發發表가 이번 美·日 半導體 摩擦再燃이 원인이 되었다는 것도 우리 業界는 간과해서는 안 될 것이다. 도토리 키재기식의 業界間의 競争은 전연 무의미한 일이며 內實을 기해야 할 때가 지금이 아닌가 생각한다.